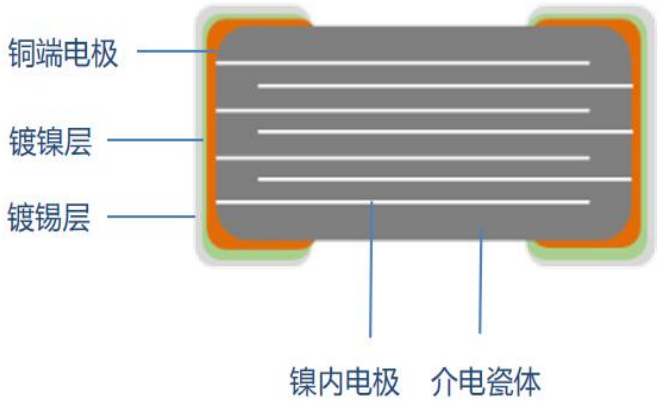
■ MLCC 用铜端电极浆料

◆ 特征

* 红色膏状流体，主要由铜粉、玻璃粉和有机黏合剂组成。
* 不含铅、镉、六价铬等禁用物质，符合 RoHS 指令环保要求。
* 应用于 BME-MLCC，作端电极用。

◆ 产品在 MLCC 中应用示意图及产品图片





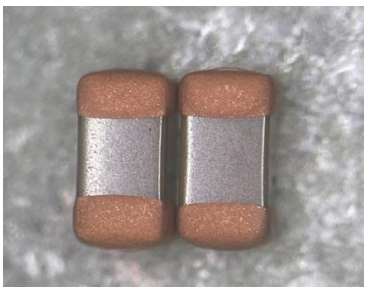
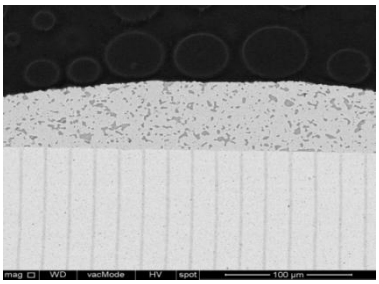
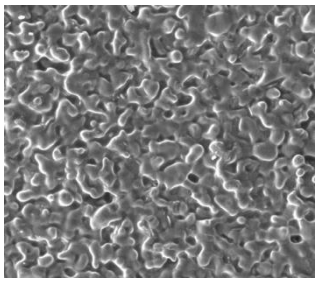
◆ 物理性能

型号	固含量（%）	粘度*（Pa·S）	细度	适用性
CB06	82.5±1.5	20.0～30.0	≤8.0μm	X7R 材料，0201-1210 规格
CB75	80.5±1.0	26.0～32.0	≤8.0μm	X7R、COG 材料，0402-1812 规格
CN31	82.4±1.5	20.0～30.0	≤8.0μm	C0G 材料，0402-0805 规格
CF63	79.8±1.0	25.0～31.0	≤8.0μm	Y5V、X7R 材料，0402-1812 规格
CF63A	80.3±1.0	35.0～45.0	≤8.0μm	X7R 材料，0201-1210 规格
CF66	81.8±1.0	24.0±2.0	≤7.5	Y5V、X7R 材料，0402-1812 规格

(注*：粘度检测条件为 Brookfield HBDV-Ⅱ+，CP52，10rpm，25±0.5℃)

◆ 产品特点

* 烧结后端头铜层致密性好。
* 导电率高。
* 烧结后与瓷体结合紧密，附着力高。

◆ 推荐工艺

* 搅　拌：使用前慢速搅拌均匀。
* 封　端：用匹配的设备及技术参数进行封端。
* 干　燥：链式烘炉（适量抽风），100～110℃(峰值温度)，25～30min（全程时间）。
　　因设备差异，客户可根据实际情况适当调试温度。
* 烧　结：在保护气氛下烧结，根据瓷体体系选择具体的烧结温度。建议烧结温度如下：

型号	烧结峰值温度（℃）	峰值时间（min）
CB06	765±10	7.5～10
CB75	855±10	10～20
CN31	755±10	10～20
CF63	930±10	10～20
CF63A	930±10	10～20
CF66	930±10	10～20

◆ 产品使用注意事项

* 电　　镀： 适用于氨基磺酸体系的电镀液。
* 清　　洗： 建议使用无水乙醇。
* 储存条件： 建议在温度 18～25℃、湿度≤75%环境密封储存，避免置于阳光直射或含有腐蚀性气体环境中。
* 有 效 期： 建议在符合上述储存条件下三个月内使用。
* 包装规范： 采用 PE 塑料瓶，500g/瓶或 1000g/瓶或 1500g/瓶。

■ 修订履历

版本	日期	修订内容	修订人
A0	2025-10-23	新版格式要求重新整理整版内容	郭精华
A1	2026-4-8	新增部分产品型号	叶自艺
A2	2026-8-28	新增 CF66 浆料性能参数，调整版本格式	叶自艺

注：上述所提供之内容为产品规格说明。在产品未变更时，风华保有修改此内容不另行通知之所有权利，任何产品变更将会以 PCN 通知客户。